

拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2004-558447
起案日 平成21年 6月 9日
特許庁審査官 田中 晃洋 3800 5R00
特許出願人代理人 津国 肇(外 1名) 様
適用条文 第29条第2項

<<<< 最 後 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項：1-7
- ・引用文献等：1, 2
- ・備考：

引用文献1(段落【0001】、【0003】、等参照)には、積層セラミックコンデンサ等の電子部品素体の外表面に形成される端子電極層を、合成樹脂(エポキシ系樹脂)に導電性粉末(Ag粉末)を分散させた導電性接着剤を塗布し、加熱により硬化させることにより形成したチップ型電子部品が記載されている。

また、引用文献2(特許請求の範囲、段落【0005】～【0014】、【0018】、【0024】、【0025】、【0028】、【0030】～【0033】等参照)には、導電性フィラーと有機バインダーからなる導電性接着剤において、前記導電性フィラーとして、Sn等の融点が300℃以下の低融点金属からなる粒子(A)と、該低融点金属の融点よりも高い融点をもつAg等の球状

や鱗片状の導電性粒子（B）を用い、前記低融点金属粒子（A）と前記導電性粒子（B）の総量を70～95重量%、前記低融点金属粒子（A）と導電性粒子（B）の配合割合が5：95～50：50（重量比）の範囲にすることにより、十分な接着性と高い導電性を有する導電性接着剤（加熱硬化条件：150～220℃）を得る技術が記載されている。

そして、上記引用文献1及び上記引用文献2は、いずれも導電性接着剤の分野に属する点で技術分野が共通しており、また、端子電極の導電性を向上させることは周知の課題に過ぎないことから、上記引用文献1の導電性粉末として、上記引用文献2に記載のSn等の融点が300℃以下の低融点金属からなる粒子（A）と、該低融点金属の融点よりも高い融点をもつAg等の球状や鱗片状の導電性粒子（B）からなる導電性フィラーを用いることにより、本願の請求項1～7に係る発明を得ることは、当業者であれば容易に想到し得た事項である。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特開2000-188228号公報 ← *
2. 特開平10-022170号公報

最後の拒絶理由通知とする理由

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C H 0 1 G 4 / 1 2 ～ 4 / 3 0 ,
 H 0 1 G 7 / 0 4 ～ 7 / 1 0

・先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせがございましたら下記までご連絡下さい。

整理番号: 発送番号:376814 発送日:平成21年 6月16日 3/E

特許審査第四部 インターフェイス 田中 晃洋

TEL. 03 (3581) 1101 内線3520

FAX. 03 (3580) 6907